

# 오이타 LSI클러스터의 활동사례

## 연구개발

### 테스트, 평가기술분야

- 테스터 번인연구WG(워킹그룹)**  
LSI 테스트장치 개발에 필요한 안정된 고신뢰성 콘택트기술을 확립한 연구개발
- 번인장치에 있어서의 챔버성능연구WG**  
소형으로 생산량에 걸맞는 다품종소량형 번인장치개발
- 테스터연구WG**  
계측기와 결합시켜 저가격을 실현한 고속신호테스트 처리장치
- ALPG 연구WG**  
소형에다 저가격의 고속패턴 제너레이터회로 연구개발
- 고속믹스시그널 간이테스터개발WG**  
소형에 저가격의 고속믹스시그널 간이테스터개발



번인장치에 있어서의 챔버성능 연구 (소형챔버)



테스터연구



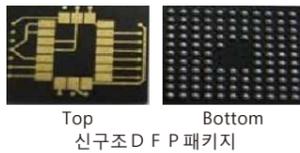
IC소켓 콘택트부세정

### 장치부품 세정기술분야

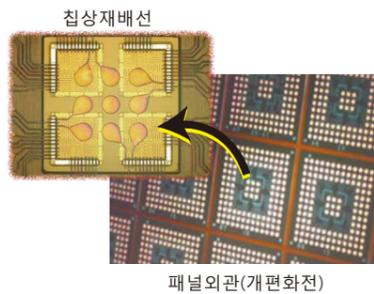
- CO<sub>2</sub> 세정기의 번인보드 세정시스템개발WG**  
CO<sub>2</sub> 세정기에 의한 번인보드 세정기술 확립

### 실장기술분야 (신패키지기술)

- Fan-Out 형 WLP용 패널스케일 Low cost 재배선기술개발WG**  
패널스케일에서의 Fan-Out 배선, 패드접속 일괄프로세스 적용에 따른 패키지용 저코스트 재배선프로세스개발
- 휴대전화용 신구조DFP패키지개발WG**  
박형화, 저코스트를 목표로 한 신구조DFP 패키지개발



Top Bottom  
신구조 D F P 패키지

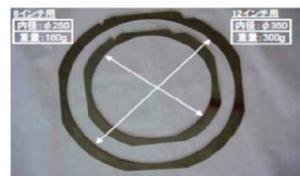


칩상재배선

패널외관(개편화전)

### 장치부품기술분야

- 12인치 경량웨이퍼링개발WG**  
중량을 60%경감한 12인치 웨이퍼링개발
- 플라스틱 웨이퍼링개발WG**  
경량이면서 강인하고 싼가격의 8인치용 고강성 플라스틱 웨이퍼링개발



웨이퍼링

### 장치화기술분야

- 엑스체인저개발WG**  
Final Test 용 소켓의 프로브핀을 자동 및 고속으로 교환할 수 있는 장치개발



엑스체인저 장치

## 인재육성

### 반도체 기초강좌 개최

신입사원, 사무부문, 간접부문을 담당하는 분들을 대상으로 반도체기초강좌를 개최함.

### 기술자연수회 개최

반도체관련 기술자를 대상으로 파워디바이스, MEMS, 메디컬 등 향후 성장이 전망되는 기술분야의 신규참여를 목적으로 한 체계적인 기술연수회를 개최함.

### 해외전개를 목표로 스킬업 연수회개최

타이완, 한국 등 동아시아와의 거래확대를 목적으로 비즈니스 스킬업 연수회를 개최함.



파워디바이스 세미나(3회시리즈)



2012.6.28-29  
타이완, 중국비즈니스 스킬업연수

## 판로개척, 정보제공

### 니즈 및 씨즈 조사, 전시회등 비즈니스매칭 지원

- 니즈, 씨즈 조사를 통한 비즈니스매칭**  
현내외의 반도체관련 대기업등을 방문하여 니즈와 씨즈를 조사, 클러스터회원과의 비즈니스매칭을 신속하게 진행시킴으로 거래확대를 목표로 함.
- 전시회 출전**  
세계최대의 반도체장치 및 재료 국제전시회인 세미콘 재팬 등에 출전. 오이타현내 기업을 널리 PR함과 동시에 연구개발 성과물 등도 소개함.



2012.12.5-7 세미콘 재팬

### 타이완, 한국과의 비즈니스교류

타이완전자설비협회와 상호교류를 위한 양해각서를 체결함으로써 비즈니스교류를 촉진함과 동시에 한국 오창반도체클러스터나 한국산업단지공단(KICOX)과 비즈니스교류를 지속함.



2012.5.11  
타이완기업과의 상담회(오이타)



2012.12.3  
상담성립조인식

## 회원교류

### 대표자세미나 개최

국내외 경영대표 상호교류회를 개최함.

### 교류회 개최

- 기술자교류회 개최**  
회원기업의 기술자를 대상으로 교류회를 개최함.
- 기타 교류활동**  
타지역의 클러스터나 해외와 교류를 실시하고 네트워크를 형성함.



2012.9.14 대표자세미나